



SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan	964054
(51) Kv.lk.6 - Int.kl.6	
H 05K 5/00, H 05K 5/02	
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	10.10.1996
(24) Alkupäivä - Löpdag	06.04.1995
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	10.12.1996
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan	PCT/US95/04291
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet	
11.04.1994 US 226149 P	02.03.1995 US 397600 P

(71) Hakija - Sökande

1. Raychem Corporation, Intellectual Property Law Department, 300 Constitution Drive, Mail Stop, 120/6600, Menlo Park, CA 94025-1164, USA, (US)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Diaz, Stephen, 482 Everett avenue, Palo Alto, CA 94301, USA, (US)
2. Horsma, Dave, 1141 Parkinson avenue, Palo Alto, CA 94301, USA, (US)
3. Kulkari, Narendra, 1045 Valencia avenue #3, Sunnyvale, CA 94086, USA, (US)
4. Lundquist, Peter, 1844 Shoreview avenue, San Mateo, CA 94401, USA, (US)
5. Nakazato, Akira, 74 Cronin Drive, Santa Clara, CA 95051, USA, (US)
6. Shen, Nelson, 4131 Old Trace Road, Palo Alto, CA 94306, USA, (US)
7. Von Der Lippe, Paul, 332 Terri Drive, #2, Loveland, CO 80537, USA, (US)

(74) Asiamies - Ombud: Berggren Oy Ab, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Tiiviisti suljettu elektroniikkapakkaus aktiivisen elektroniikan suojaamiseksi
ympäristöltä
Tätsluten elektronikförpackning för skydd av en aktiv elektronik mot omgivning

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Ympäristöltä suljettu elektroniikkakokoonpano (100). Kokoonpano sisältää joustavan vaipan (10), joka ympäröi aktiivista elektroniikkapiirilevyä (1000). Elektroniikkapiirilevy asetetaan vaippaan, joka sen jälkeen suljettuna muodostaa ympäristöltä suljetun, uudestaan avattavan aktiivisen elektroniikkapakkauksen. Selitetään myös menetelmiä kokoonpanon valmistamiseksi.

Elektronisk sammansättning (100) som slutits mot omgivningen. Sammansättningen innehåller ett flexibelt hölje (10) som omger det aktiva elektroniska kretskortet (1000). Det elektroniska kretskortet kan stickas in i höljet varefter kapsling åstadkommer ett mot omgivningen slutet aktivt elektronikpaket som åter kan öppnas. Man beskriver även metoder för tillverkning av sammansättningen.

